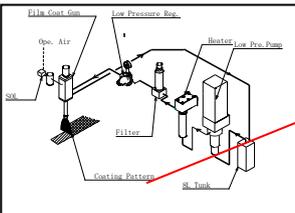
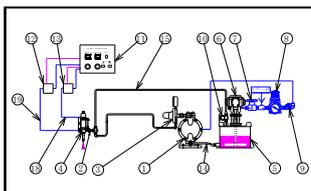
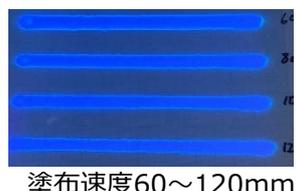
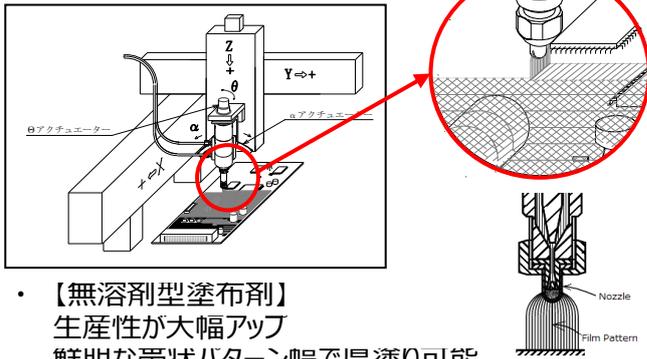


展示No	区分	<input type="checkbox"/> 部品 <input type="checkbox"/> 素材/材料 <input checked="" type="checkbox"/> 設備/装置 <input type="checkbox"/> 金型/治工具 <input type="checkbox"/> システム/ソフトウェア <input type="checkbox"/> その他 ()		
34-1	提案名	高粘度液体の飛散レス帯状塗布装置		工法 非接触帯状塗布 新規性 世界初
会社名		Shimada Appli(同)		
所在地		埼玉県川口市前川3-7-1 5AZAMI101		
連絡先		URL :http://shimadaappli.com/		
部署名 : 代表社員		Tel No. 048-269-7703		
担当名 島田 隆治		E-mail tshimada@shimadaappli.com		
主要取引先		海外対応	海外拠点	
(株) エーアンドエー茨城 コダック(同) タナシ乳業(株) 日本板硝子(株) 日本電波工業(株) 三井化学(株) (株) 日立パワーソリューションズ 矢崎部品(株)		<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 有(韓国、中国)	

<< 提案内容 >>

提案の狙い <input checked="" type="checkbox"/> 原価低減 <input type="checkbox"/> 軽量化 <input checked="" type="checkbox"/> 生産(作業)性向上 <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 <input checked="" type="checkbox"/> 安全/環境対策/CN対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他(低コスト自動化推進)	適用可能な製品/分野 ・実装基板防湿塗布 ・各種接着剤部分塗布 ・潤滑剤塗布 ・UV系液剤塗布 ・無溶剤型シリコン材塗布 ・各種導電剤ライン塗布																							
従来 従来の非接触で帯状塗布するには、粘度200センチポイズ(CPS)が限界であった。 ・【溶剤型塗布剤を帯状塗布する場合】 100CPS以下に希釈して使用 溶剤使用量多く、厚塗りが不可  装置フロー フィルムコートガン 矩形ノズルにて ・【無溶剤型塗布剤】 2流体スプレー塗布が一般的で帯状境界部が不鮮明 塗布速度が200mm/秒以下でないと成膜不十分 生産性が悪く液詰まり、飛散しやすい  2流体塗布装置フロー  塗布速度60~120mm/sec	新技術・新工法 開発した1流体塗布ノズルで200~3000センチポイズ(CPS)の塗布液を、フィルム状パターンを形成して帯状塗布や面塗布が可能な液膜形成塗布システム。 ・【溶剤型塗布剤を帯状塗布する場合】 200~1000CPSの原液をそのまま使用 厚塗りが1回で可能  ・【無溶剤型塗布剤】 生産性が大幅アップ 鮮明な帯状パターン幅で厚塗り可能 開発ノズルを使用して塗布速度300~800mm/秒 粘度970mPas 防湿絶縁材 Dow Corning1-2577 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>塗布速度 (mm/sec)</th> <th>300</th> <th>400</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">塗布高さ 10mm</td> <td>膜厚(μm)</td> <td>148±2</td> <td>117±1.5</td> <td>96±1.5</td> </tr> <tr> <td>塗布幅 (mm)</td> <td>14.4±0.2</td> <td>14±0.1</td> <td>13.3±0.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗布高さ 15mm</td> <td>膜厚(μm)</td> <td>131±4</td> <td>100±3</td> <td>91±3</td> </tr> <tr> <td>塗布幅 (mm)</td> <td>16.8±0.3</td> <td>16.3±0.1</td> <td>14.3±0.1</td> </tr> </tbody> </table> MAX1000mm/sec対応		塗布速度 (mm/sec)	300	400	500	塗布高さ 10mm	膜厚(μm)	148±2	117±1.5	96±1.5	塗布幅 (mm)	14.4±0.2	14±0.1	13.3±0.1	塗布高さ 15mm	膜厚(μm)	131±4	100±3	91±3	塗布幅 (mm)	16.8±0.3	16.3±0.1	14.3±0.1
	塗布速度 (mm/sec)	300	400	500																				
塗布高さ 10mm	膜厚(μm)	148±2	117±1.5	96±1.5																				
	塗布幅 (mm)	14.4±0.2	14±0.1	13.3±0.1																				
塗布高さ 15mm	膜厚(μm)	131±4	100±3	91±3																				
	塗布幅 (mm)	16.8±0.3	16.3±0.1	14.3±0.1																				
セールポイント (製造可能な精度/材質等) ・粘度3000CPSまでの液体材料等を見切りの良いフィルム状パターンによる塗布が可能 ・±20%の粘度範囲でも塗布安定性が良い ・基板防湿塗布の表面塗布にも最適である ・50%以上の生産性改善	問題点 (課題) と対応方法 ・薄膜形成塗布には不適 ・薄塗用にはFSCC06マイクロスプレーにて対応																							
開発進度 (2024年7月 現在) <input type="checkbox"/> アイデア, <input type="checkbox"/> 試作/実験, <input type="checkbox"/> 開発完了, <input checked="" type="checkbox"/> 製品化完了	特許有無 国内特許取得済																							
従来との比較	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>コスト</th> <th>軽量化</th> <th>(生産)作業性</th> <th>その他(品質、環境対策)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数値割合</td> <td>60%以上削減</td> <td>-</td> <td>50%向上</td> <td>50%以上向上</td> </tr> </tbody> </table>	項目	コスト	軽量化	(生産)作業性	その他(品質、環境対策)	数値割合	60%以上削減	-	50%向上	50%以上向上													
項目	コスト	軽量化	(生産)作業性	その他(品質、環境対策)																				
数値割合	60%以上削減	-	50%向上	50%以上向上																				